

The logo for Microbond, featuring a stylized blue wave above the word "MICROBOND" in a bold, sans-serif font.

Microbond® SMT660 Innolot™ 免清洗型 T4 号粉印刷锡膏

Microbond® SMT660 Innolot™ 是一种高可靠性、高性能印刷锡膏，可实现极具竞争力的总拥有成本 (TCO)。作为业界知名的焊接合金，Innolot™ 具有更高的抗蠕变性，从而延长产品在更高工作温度下的使用寿命。SMT660 Innolot™ 锡膏可在空气环境中进行回流焊，无需氮气保护，同时保持低缺陷率，降低总拥有成本。具体而言，这意味着更少的针孔和吹孔缺陷、超低的 BGA 空洞率和更小的空洞面积。

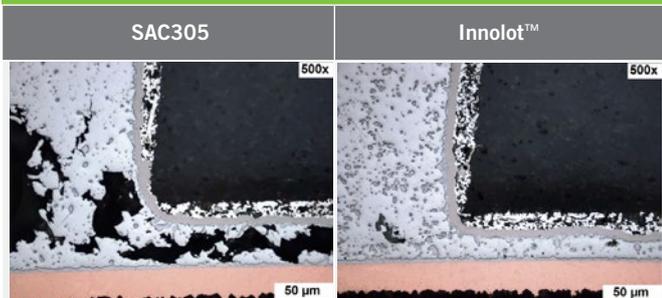
主要优势

- Innolot™ 锡膏可在空气环境下焊接，亦能实现较低缺陷
- 丙烯酸类合成树脂确保稳定的质量
- 减少针孔和吹孔缺陷
- 高可靠性合金和高表面绝缘电阻
- 空洞面积小
- 零卤素

在 MLF 48 上的空洞示例 (空气回流焊)

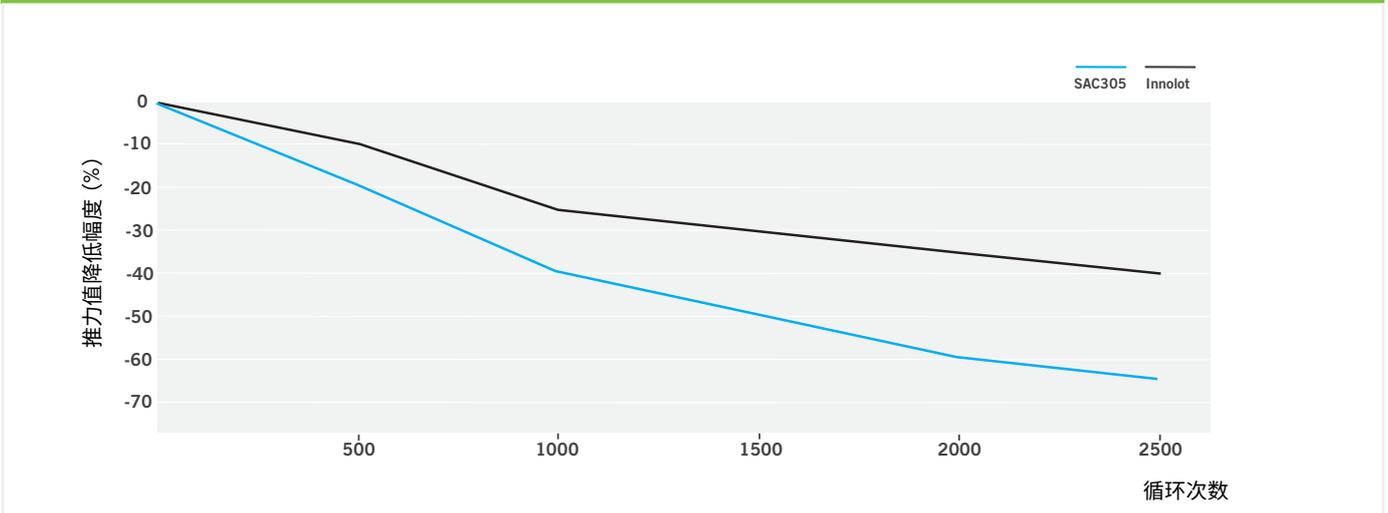


尺寸为 1206 的电阻元件，经 2000 小时、-40°C 到 25°C 温度循环测试后的截面图



产品特性	Microbond® SMT660 Innolot™
合金	Innolot™
金属含量	89%
焊粉级别	4 号粉
卤素含量	零卤素
助焊剂类别	免清洗型
焊粉特性	
粒径	20 - 38 μm
合金	Sn/Ag3.8/Cu0.7/Ni0.15/Sb1.5/Bi3
熔点	206 - 218 °C
储存条件	
温度	2 - 10 °C

基于尺寸为 1206、端面化学镀锡的电阻元件，在 -40°C 到 125°C 温度循环下的可靠性对比



美洲
电话 +1 610 825 6050
electronics.americas@heraeus.com

亚太区
电话 +65 6571 7649
electronics.apac@heraeus.com

中国
电话 +86 53 5815 9601
electronics.china@heraeus.com

欧洲、中东和非洲
电话 +49 6181 35 4370
electronics.emea@heraeus.com

本文所述事实与技术数据均由贺利氏利用最新知识和现代实验设备根据通用实验流程测定得出。文中信息均为出版前最新版本(可索要最新版本文件)。尽管数据均准确无误，但贺利氏对上述数据是否得到合理引用或因引用上述数据导致的任何侵权后果均不承担任何责任(除非事先以协议的形式征得明确的书面同意)。使用者应根据本文所提供的数据针对特定应用对材料适用性进行测试。贺利氏标识、贺利氏、Heraeus、Innolot™、Microbond® 和 Microbond 图形商标均为贺利氏集团或其附属公司的商标或注册商标。保留所有权利。